

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 21 年 5 月 28 日 (2009.5.28)

【公開番号】特開 2006-332612 (P2006-332612A)

【公開日】平成 18 年 12 月 7 日 (2006.12.7)

【年通号数】公開・登録公報 2006-048

【出願番号】特願 2006-115406 (P2006-115406)

【国際特許分類】

H 0 5 K 3/36 (2006.01)

H 0 5 K 1/11 (2006.01)

H 0 5 K 3/00 (2006.01)

G 0 1 R 31/04 (2006.01)

【F I】

H 0 5 K 3/36 Z

H 0 5 K 1/11 Z

H 0 5 K 3/00 T

G 0 1 R 31/04

【手続補正書】

【提出日】平成 21 年 4 月 9 日 (2009.4.9)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】検査方法

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

半導体集積回路に設けられた接続端子と、フレキシブルプリント配線板に設けられた圧着接続端子との接続状態を、前記フレキシブルプリント配線板に設けられ、且つ前記接続端子に電氣的に接続された圧着検査端子によって検査することを特徴とする検査方法。

【請求項 2】

半導体集積回路に設けられた複数の接続端子の一つと、フレキシブルプリント配線板に設けられた圧着接続端子との接続状態を、前記フレキシブルプリント配線板に設けられ、且つ複数の前記接続端子に対して電氣的に接続された一本の圧着検査端子によって検査することを特徴とする検査方法。

【請求項 3】

半導体集積回路が封止された状態で、

前記半導体集積回路に設けられた接続端子と、フレキシブルプリント配線板に設けられた圧着接続端子との接続状態を、前記フレキシブルプリント配線板に設けられ、且つ前記接続端子に電氣的に接続された圧着検査端子によって検査することを特徴とする検査方法。

【請求項 4】

請求項 1 乃至請求項 3 のいずれかーにおいて、

前記接続状態は、前記接続端子と前記圧着接続端子の間の抵抗値を測定することで検査されることを特徴とする検査方法。

【請求項 5】

半導体集積回路とフレキシブルプリント配線板との電氣的接続を検査する検査方法であって、

前記半導体集積回路は複数の接続端子を有し、

前記フレキシブルプリント配線板は、複数の配線と、検査用配線とを有し、

複数の前記配線は圧着接続端子と第 1 の外部接続端子をそれぞれ有し、

前記検査用配線は圧着検査端子と第 2 の外部接続端子を有し、

複数の前記接続端子のそれぞれを、対応する複数の前記配線の前記圧着接続端子とそれぞれ電氣的に接続し、

複数の前記接続端子のそれぞれを、前記圧着検査端子と電氣的に接続し、

前記第 1 の外部接続端子と前記第 2 の外部接続端子との間の抵抗値を測定することによって、複数の前記接続端子のそれぞれと前記圧着接続端子との接続状態を検査することを特徴とする検査方法。

【請求項 6】

請求項 1 乃至請求項 5 のいずれか一において、

前記接続端子と前記圧着接続端子は、異方性導電膜を介して電氣的に接続されることを特徴とする検査方法。

【請求項 7】

請求項 1 乃至請求項 6 のいずれか一において、

前記検査の後、前記接続端子と前記圧着検査端子との接続を切断することを特徴とする検査方法。

【請求項 8】

請求項 1 乃至請求項 6 のいずれか一において、

前記検査の後、前記フレキシブルプリント配線板に設けられている切り口及び開口部よりも前記半導体集積回路側に設けられている前記圧着検査端子及び前記フレキシブル配線板の一部を前記切り口及び開口部から切り離すことにより、前記接続端子と前記圧着検査端子との接続を切断することを特徴とする検査方法。

【請求項 9】

請求項 6 において、

前記検査の後、前記接続端子と前記圧着検査端子との接続を切断すると共に前記異方性導電膜の一部を除去し、

前記異方性導電膜が除去された領域に樹脂材料を充填することを特徴とする検査方法。

【請求項 10】

請求項 1 乃至請求項 9 のいずれか一において、

前記圧着接続端子は、前記接続端子に対し垂直に跨ぐ形状を有することを特徴とする検査方法。